

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Technical Bulletin

Nº 2003

Pautas de calibración de soldadura por inducción

Julio 2020

Pautas de calibración al usar placas de soldadura por inducción Mule-Hide:

1. Corte un trozo de membrana que se utilizará en el trabajo.
2. Coloque la membrana sobre el sustrato que se está utilizando en el proyecto.
3. Coloque 5 placas debajo de la membrana al menos a 10" de distancia. En la parte superior de la membrana, marque el centro de la placa.
4. Centre la soldadora de inducción sobre la placa. Durante la temperatura ambiente promedio, coloque la configuración de la soldadora en 00 y comience el proceso de soldadura. Inmediatamente después de la secuencia de soldadura, coloque un imán disipador de calor sobre la parte superior de la placa.
5. Identifique y anote la configuración del soldador utilizada en cada placa.
6. Continúe el proceso de calibración para el resto de las placas aumentando el ajuste en +01 para cada placa.
7. Una vez que las placas hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse, voltee la membrana y retire las placas con un par de bloqueos de canal o una herramienta similar que asegure la membrana con el pie.

El objetivo del proceso de calibración es encontrar el ajuste que creará la unión óptima. Si esa unión no se logra en el primer conjunto de muestras, es posible que el operador deba aumentar o disminuir la configuración desde el inicio de la selección de calibración inicial.

La temperatura ambiente, el grosor de la membrana y el voltaje son variables importantes en el rendimiento de las soldaduras. Si la temperatura cambia $\pm 15^\circ \text{F}$ después de la calibración inicial, la máquina debe recalibrarse para garantizar una unión adecuada. Cada máquina utilizada en el trabajo debe calibrarse por separado.

Una buena soldadura debe tener una cobertura completa de 360° desde la parte inferior de la membrana hasta el área elevada en la parte superior de la placa. Una mala soldadura tendrá áreas faltantes de unión entre la placa y la membrana. Se debe tener cuidado de no soldar la membrana demasiado caliente. Una decoloración significativa del ISO y un posible humo pueden resultar de una configuración de soldadura por inducción demasiado alta (demasiado calor). Nunca suelde directamente sobre EPS o XPS sin una barrera adecuada.



Buena soldadura



Mala soldadura



Mala soldadura